

國家科學及技術委員會新聞稿附件 第 30 次園區審議會核准投資案

一、圓達科技股份有限公司中科分公司（設立於中部科學園區之臺中園區）

本案投資金額 2 億元，主要產品為半導體高分子高潔淨高耐化零組件、半導體設備智慧電控模組及高耐化高耐壓半導體特用化學桶等。

本案公司聚焦半導體產業關鍵零組件與智慧電控模組開發，具備完整熱分析與材料檢測能力，能精準掌握材料熱穩定性、低析出特性，同時導入製程參數與能源管理系統，強化線上監測及製程穩定性，並投入特用化學桶開發與再利用清洗技術，符合半導體高階封裝零組件需求及低碳轉型趨勢。另公司亦參與「台灣半導體德鑫二聯盟」，透過跨領域協作促進製程經驗與品質規範系統化累積，未來將持續深化在地供應能力，提升供應鏈韌性，維持臺灣半導體產業於國際供應鏈中的競爭優勢。

二、恆豐國際電子股份有限公司中科分公司（設立於中部科學園區之虎尾園區）

本案公司為國內唯一整合 IC→晶片→封裝→鏡頭→機芯模組的一站式技術供應商，替客戶進行紅外熱成像客製化設計、製造與測試，並提供客戶不同尺寸的探測器選項、機芯製造及測試服務。此外，也為客戶產品提供校準服務、相關技術支援與教育訓練。

本案公司規劃設立國內第一條完整的 MIT 紅外探測器封裝產線，除協助臺灣紅外供應鏈的自主性與產業升級外，也加速紅外產業技術發展，提升製造效率與品質穩定性。

三、天瀚科技股份有限公司（設立於新竹科學園區之新竹園區）

本案投資金額 8 億元，主要產品為網格型資料存儲系統、切片產業專屬網路及智能才賦接砌邊緣設備。

本案公司所推出之三大核心產品，其中網格型資料存儲系統（ECI）提供企業自主進化的私有 AI 訓練平台，有助於提升資料分析與資安防護能力；切片產業專屬網路（SPF）提供專為 AI 應用打造的網路架構，具備端到端通訊延

遲低與高安全性，可依據客戶需求彈性調整頻寬和連線能力；智能才賦接砌邊緣設備（TME）則提供跨企業數據、模型、人才交換與媒合平台，透過區塊鏈驗證機制確保數據交換的透明與可信度。三大核心產品彼此間可相互搭配或單獨運作，旨在將企業內部資料資產、智慧決策機制與外部連網環境整合成一體化基礎建設。

本案公司積極推動從產品製造商到平台架構供應商的轉型，並結合園區產業聚落資源，促進人工智慧應用發展，公司以系統性布建與高度客製彈性的解決方案，有助於客戶企業數位轉型與自主演化。

四、群聯電子股份有限公司竹北分公司（設立於新竹科學園區之生醫園區）

本案投資金額約 2.06 億元，主要產品為 AI 智慧診療輔助系統。

本案母公司為全球 NAND Flash 控制晶片暨儲存解決方案領導廠商，首創將高速儲存技術導入醫療場域，提供一個軟硬整合的地端訓練 AI 模型的解決方案，透過獨家專利技術實現大語言模型與影像模型於地端環境進行訓練與推論，應用於 X 光、電腦斷層、超音波等醫療影像判讀情境，結合既有醫療資訊系統，智慧化輔助醫師處理大量臨床影像資料，以提升診斷準確率並減輕醫護人力負擔，協助醫療機構強化智慧化診療能力。

本案公司進駐新竹生醫園區後可就近串聯醫療院所、生技醫材單位及 AI 醫療新創，結合園區既有半導體與資通訊產業能量，帶動醫療服務價值提升與臨床流程優化，推升我國在 AI 及高階醫療器材研發上的整體競爭力。

五、泰坦分子生醫股份有限公司竹科分公司（設立於新竹科學園區之生醫園區）

本案投資金額 1.2 億元，主要產品為快速核酸檢驗儀、微型快速樣品製備儀、多標的檢測試劑耗材、藥物敏感性檢測儀及 AI 輔助分析服務。

本案開發以多標快速核酸檢測平台為核心，結合超快速熱循環增幅模組與專利光學偵測系統，可於 10~20 分鐘內完成 3~15 標的同時檢測，並以常溫乾燥卡匣形式保存試劑超過 12 個月，未來擬增加微流體藥敏測試與 AI 雲端分析功能，實現多場域點測，並可即時輔助診斷與個人用藥建議。

本案產品涵蓋光學檢測、熱循環模組、微流體晶片、AI 演算法等跨領域技術，扣合國內產業優勢，有機會整合醫材產業鏈與學研單位在分子診斷、精準醫療、智慧醫療等領域的研發能量，形成技術外溢與知識累積，強化臺灣在精準健康產業的國際定位。

六、微影半導體股份有限公司竹科分公司（設立於新竹科學園區之新竹園區）

本案投資金額 0.5 億元，主要產品為配合其總公司自產之半導體設備所開發之半導體曝光機電控軟體、塗佈顯影機電控軟體及檢測設備電控軟體。

本案總公司成立於 2023 年，專注於半導體晶片曝光設備研發及製造，擁有英美頂尖曝光機專家之技術團隊，以其自主研發之 LED 光源投影曝光機，為全球半導體產業提供高效、環保、客製化的解決方案。

本次於新竹園區設立分公司，將聚焦半導體關鍵設備之電控與智慧化控制技術，支援總公司硬體設備生產，可望能逐步降低對外國設備依賴，於提升國內設備自主化與產業升級深具潛力。

七、禾豐創新生技股份有限公司宜蘭分公司（設立於新竹科學園區之宜蘭園區）

本案投資金額 0.2 億元，主要產品為零石化洗衣精、零石化家事全效清淨液，及結合物聯網 (IoT) 技術的 iNUCLEAN 智慧補充站研發與擴充模組整合開發。

本案公司致力於開發全臺第一款零石化、天然成分清潔用品，其核心產品 NUCLEAN 通過 USDA Biobased 100% 無石化成分認證及美國 FDA 認證實驗室的非致敏、非刺激的最高標準認證；同時開發 iNUCLEAN Station 裸售系統進行減塑，並依據 Scope 4 碳減量概念，透過即時數據化追蹤消費行為，達成減碳目標。此創新模式榮獲多項國際殊榮，並已通過全球最大環保生態獎—威廉王子永續獎 (The Earthshot Prize 2026) 初選。

八、恰口科研企業股份有限公司（設立於新竹科學園區之新竹園區）

本案投資金額 0.4 億元，主要產品為碳晶讚植物保護製劑、碳晶讚農產品保鮮製劑、甲晶讚土壤改質劑、廢木料再生萆菌太空包。

本案公司主要研發甫獲專利之碳晶球，透過碳晶球表面改質等處理技術，可將農業廢棄物（如竹材、果皮、籽等）製成農業上可應用之商品，解決因為極端氣候造成之高病害、高廢棄的問題，增加農民收益同時達到友善環境以推動農業永續。

同時，碳晶球等技術亦可應用於回收科學園區半導體、電子業大量之事業廢棄物（如木棧板、木包裝箱、廢塑膠包材等）材料，循環再製成葷菌太空包等產品，由於可回收再製，相較於以往以焚燒等方式處理廢棄物將更加節能環保，並協助企業生產鏈中增加減碳再循環之解決方案，降低整體碳排數值。

九、新寶紘科技股份有限公司南科分公司（設立於南部科學園區之臺南園區）

本案設立南科分公司建置前瞻研發中心，專注於半導體製程用膠材之研發。該公司由新應材、南寶樹脂及信紘科三家公司共同投資成立，整合半導體特用材料、接著劑合成與精密塗佈製程等關鍵技術，形成高度整合且具前瞻性的研發能量。公司發展目標在於推動臺灣「技術主權自主化」與「關鍵材料在地化」，以突破長期受制於外商供應之產業結構，並進一步將既有之半導體輔助膠材，升級為具戰略意義之永久性關鍵材料。未來進駐南科後，將實質建構不可替代之關鍵材料供應體系，強化臺灣於全球半導體產業戰略關鍵地位。